

# 厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2424号”文注册，厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。

厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。发行价格为每张人民币100元。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2021年10月15日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一（3年期）票面利率为3.40%，品种二（5年期）票面利率为3.87%。

发行人将按上述票面利率于2021年10月18日至2021年10月19日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行  
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：厦门金圆投资集团有限公司



2021年10月15日

(本页无正文,为《厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行  
科技创新公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人: 中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行  
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021年0月15日

---

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行  
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2021年10月15日

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行  
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：金圆统一证券有限公司

